

当社の豊富な知識と経験で部品のお困りごとをサポートします。

電子部品の内部欠陥調査のご案内

半導体デバイスなどの電子部品は、基板実装時や実際の使用時に熱機械的ストレスにさらされ、各種接合部に“はく離”などの内部欠陥が生じることがあります。

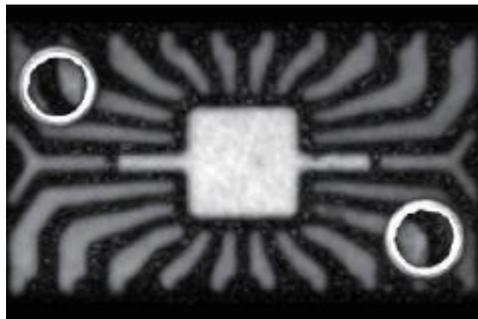
内部欠陥は、部品動作不良の原因となります。

当社では、電子部品の内部欠陥を調査する手段として、X線透視（CTによる断層観察含む）、超音波顕微鏡観察、断面観察などを提供しています。

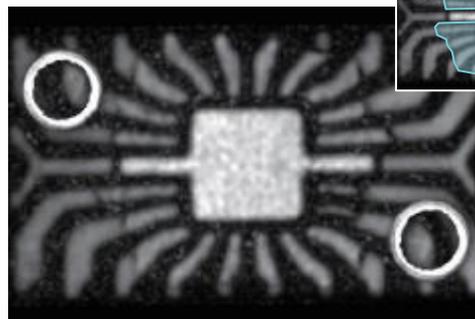
X線透視、超音波顕微鏡、断面観察などの各種手法には、それぞれにメリット、デメリットがありますので、観察対象、目的により最適な方法をご提案いたします。

電子部品の内部欠陥調査をご検討の際には、ぜひ当社にご相談ください。

超音波顕微鏡観察事例



冷熱ストレスなし品の超音波顕微鏡画像
内部はく離は確認できない。



冷熱ストレス印可品の超音波顕微鏡画像
内部はく離が確認できる。
はく離箇所は、右上写真中の囲み部。

ご依頼の流れ

①お問い合わせ



②実施内容の調整



③お見積り



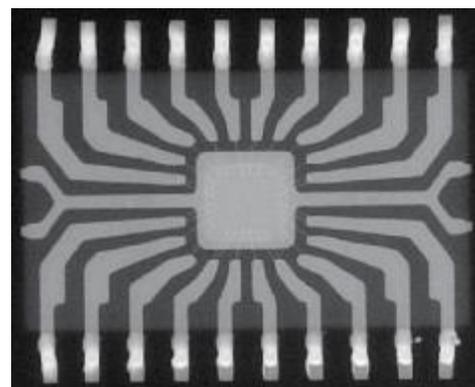
④ご注文



⑤試験実施



⑥結果の報告(納品)



冷熱ストレス印可品のX線透視画像
超音波顕微鏡画像で確認できた
内部はく離が確認できない。

●詳細は、下記当社担当までお問い合わせください

